

重庆臻宝科技股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金向全资子公司武汉臻宝半导体科技有限公司（以下简称“武汉臻宝”）提供总额不超过25,000万元的无息借款，用以实施公司超募资金所投资建设的新项目“半导体零部件研发生产基地项目”（以下简称“超募项目”）。公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,882.2600万股，发行价为人民币44.56元/股，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用（不含税）人民币12,516.43万元，实际募集资金净额为人民币160,477.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具天健验〔2026〕8-5号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.32	75,185.06
2	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	28,166.56
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	16,400.68
合计		128,336.42	119,752.30

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为40,724.78万元。

公司拟使用部分超募资金通过全资子公司武汉臻宝投资建设新项目“半导体零部件研发生产基地项目”，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-007）。

三、本次使用部分超募资金向全资子公司提供借款的情况

公司全资子公司武汉臻宝为超募资金投资建设新项目“半导体零部件研发生产基地项目”的实施主体，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用超募资金向武汉臻宝提供总额不超过25,000.00万元的无息借款，用于“半导体零部件研发生产基地项目”建设。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向武汉臻宝发放借款。借款期限为自实际发生之日起至“半导体零部件研发生产基地项目”实施完毕止，根据项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

四、借款对象的基本情况

公司名称	武汉臻宝半导体科技有限公司
法定代表人	王兵
注册资本	6,000万元人民币

公司名称	武汉臻宝半导体科技有限公司
成立日期	2026年2月25日
注册地址	湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼772
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；技术进出口；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司持股100%
最近一年主要财务数据 （单位：万元）	不适用

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用部分超募资金向武汉臻宝提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等均符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资金专户进行管理，武汉臻宝将设立募集资金专户，公司、武汉臻宝将与保荐人及募集资金专户监管银行签订《募集资金专户存储监管协议》，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求规范使用募集资金，保障募集资金的使用安全。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用超募资金向全资子公司武汉臻宝提供总额不超过25,000万元的无息借款，用以实施公司超募资金所投资建设的新项目“半导体零部件研发生产基地项目”。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经由公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用超募资金向武汉臻宝提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日